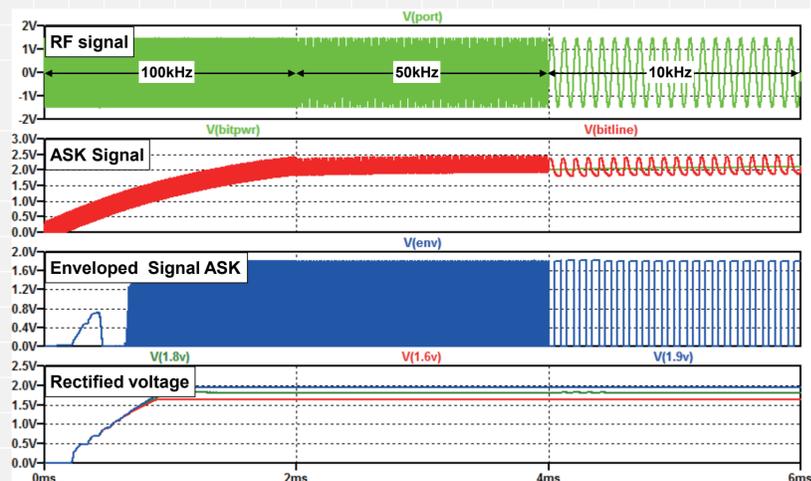
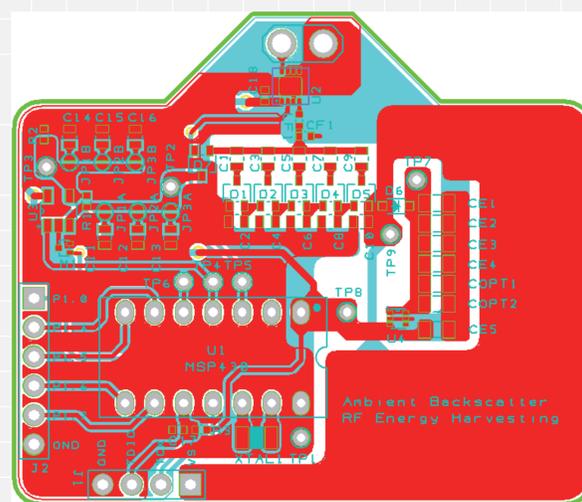


SPICE シミュレーションを駆使し、基本設計を行い、アンテナの最適化設計も含め、回路設計を行い、基板設計も含め高性能を実現



SPICE シミュレーションで基本設計検証を実施



基本的に WISP 構成です。アンテナとインピーダンス整合部品、RF 信号から電力を回収するハーベスティング回路、WISP に送られたデータを抽出する復調器、WISP からデータを送信する変調器、電源 IC、マイコン (MSP430) から構成されています。

### 特徴

- SPICE シミュレーションを活用した基本回路動作の検証を実施。
- アンテナの最適化とインピーダンス整合部品の最適な選定を行います。
- RF 信号から電力を回収するハーベスティング回路設計をおこないます。
- 必要に応じて MCU のプログラミング開発も行います。
- これらの機能をベースにカスタマイズできます。

## ■ 回路設計事例

マイクロコントローラによる電源回路

モーター制御回路

センシング回路

環境発電回路

降圧チョッパ回路

フライバック回路

プッシュプル回路

ZETA 回路

電流共振回路

アクティブクランプ回路

マルチフェーズ回路

疑似共振回路

二次電池アプリケーション回路

インバータ回路

FCC 回路

昇圧チョッパ回路

フルブリッジ回路

CUK 回路

絶縁 CUK 回路

E 級共振回路

位相シフト回路

三相フルブリッジインバータ回路

PFC 回路

LED ドライブ回路

メガソーラーシステム回路

RCC 回路

昇降圧チョッパ回路

ハーフブリッジ回路

SEPIC 回路

電圧共振回路

複共振回路

同期整流回路